

加速度量測模組加工與組立

- 對應計畫:

1. R353C73630

- 目的/用途:

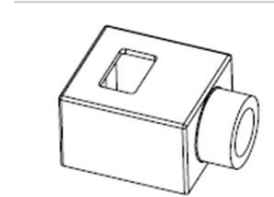
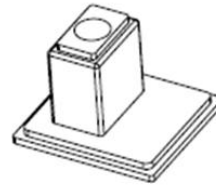
1. 加速度量測模組場域測試使用。

- 預計達成效果或產生之效益:

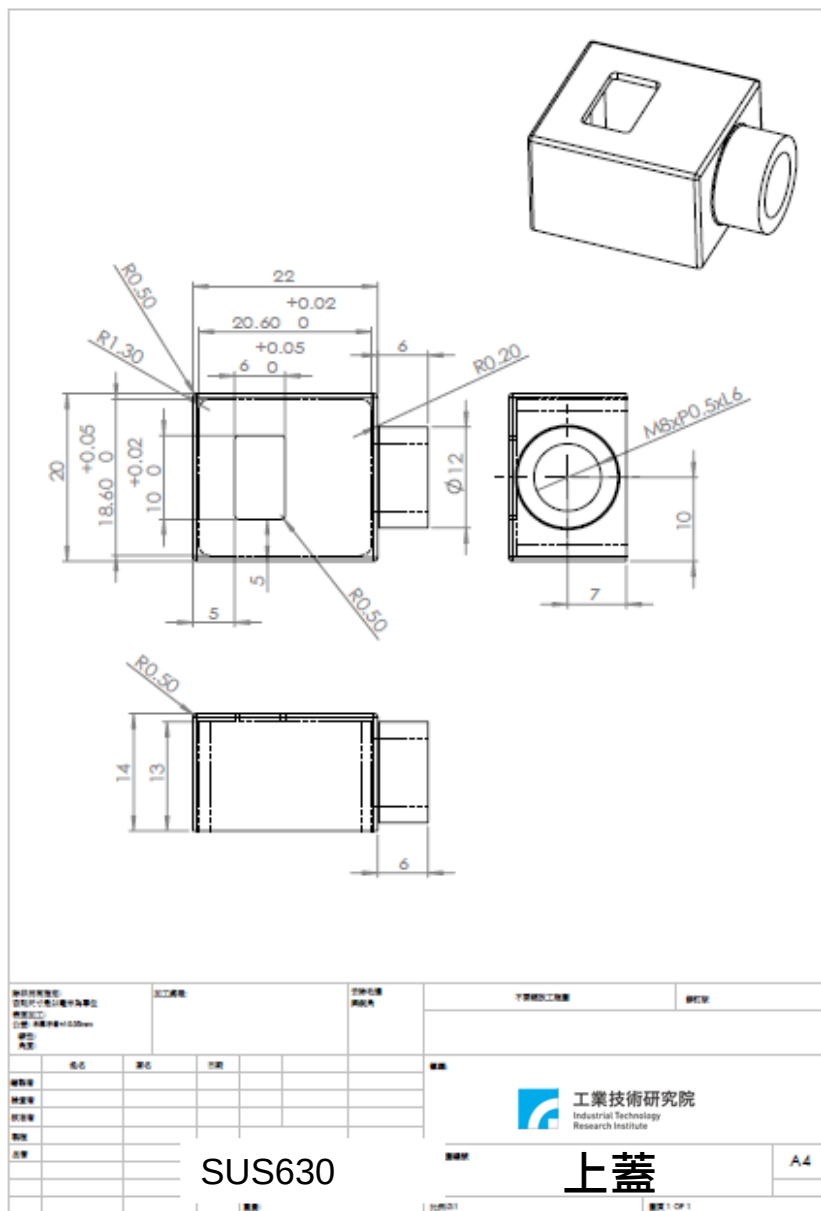
1. 作為場域測試之模組外殼製作與封裝的供應使用，導入無人機整機廠，達到智能監控。

- 規格:

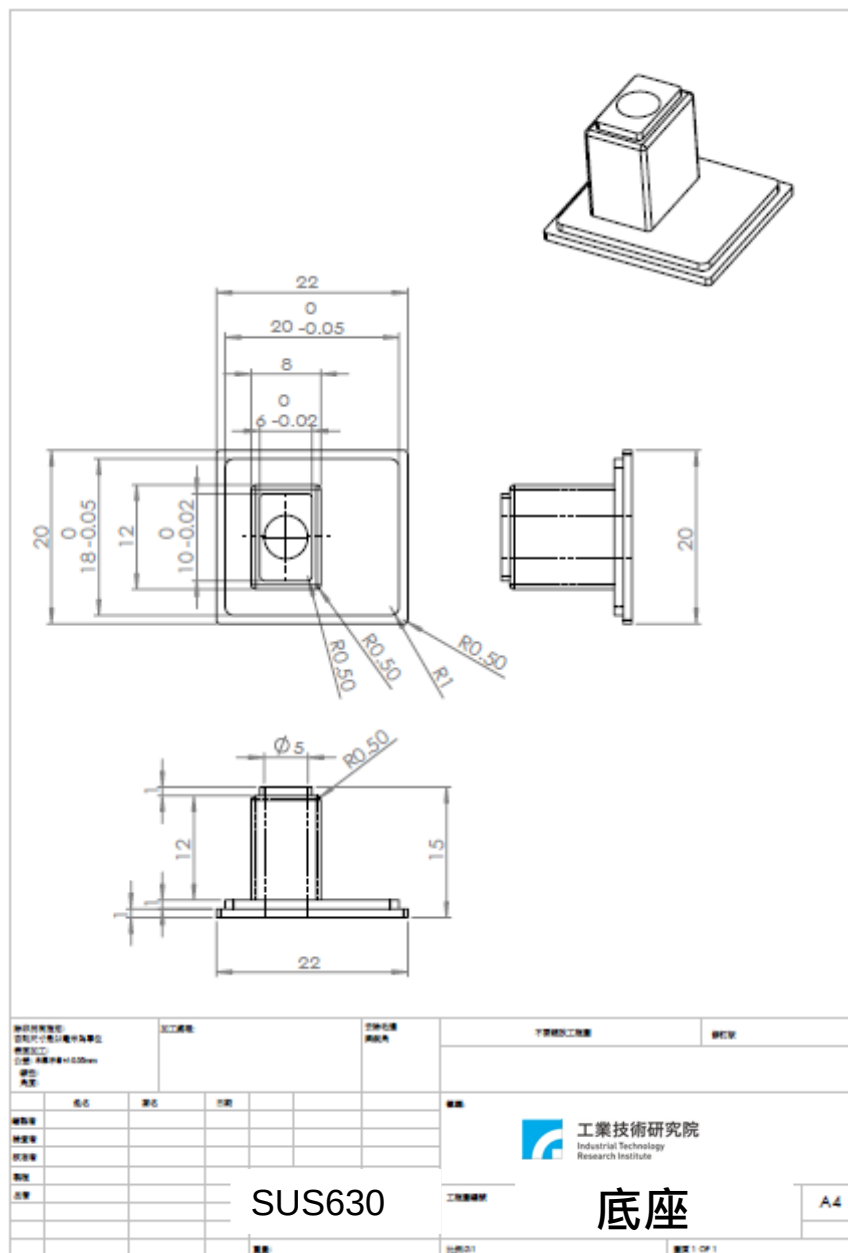
1. 進行傳感元件、上蓋、底座、訊號擷取頭之組立。
2. 於得標後，我司提供傳感元件進行組裝(尺寸:22*20*15mm)。
3. 組裝公差需 $<0.04\text{mm}$ ，平行度 0.01mm 。
4. 感測模組組裝後，規格:訊號輸出速度 $>9.5\text{kHz}$ ，感測模組感測頻寬需大於 5.5kHz ，零點偏移 $<3\%$ ，解析度16bits。(須至南創進行驗證)
5. 組裝焊接後須具IP68防水/防塵。(外觀不可有焊接痕跡，需再經研磨)



上蓋



底座



訊號擷取頭



WIRE LIST:

P1	OPEN
1	RED
2	BLACK
3	WHITE
4	GREEN
5	YELLOW
6	BROWN
7	BLUE
8	ORANGE